

Dell EMC PowerEdge T340

技术规格

注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 技术规格	4
机箱尺寸.....	4
系统重量.....	5
处理器规格.....	5
支持的操作系统.....	5
PSU 规格.....	5
冷却风扇规格.....	6
系统电池规格.....	6
扩充卡规格.....	6
内存规格.....	6
存储控制器规格.....	7
驱动器规格.....	7
驱动器.....	7
光盘驱动器.....	7
磁带驱动器.....	7
端口和连接器规格.....	8
USB 端口规格.....	8
NIC 端口规格.....	8
串行连接器规格.....	8
VGA 端口规格.....	8
IDSDM 模块.....	8
视频规格.....	8
环境规格.....	9
标准操作温度.....	10
扩展操作温度.....	10
微粒和气体污染规格.....	11

技术规格

本节概述了系统的技术规格和环境规格。

主题：

- 机箱尺寸
- 系统重量
- 处理器规格
- 支持的操作系统
- PSU 规格
- 冷却风扇规格
- 系统电池规格
- 扩充卡规格
- 内存规格
- 存储控制器规格
- 驱动器规格
- 端口和连接器规格
- 视频规格
- 环境规格

机箱尺寸

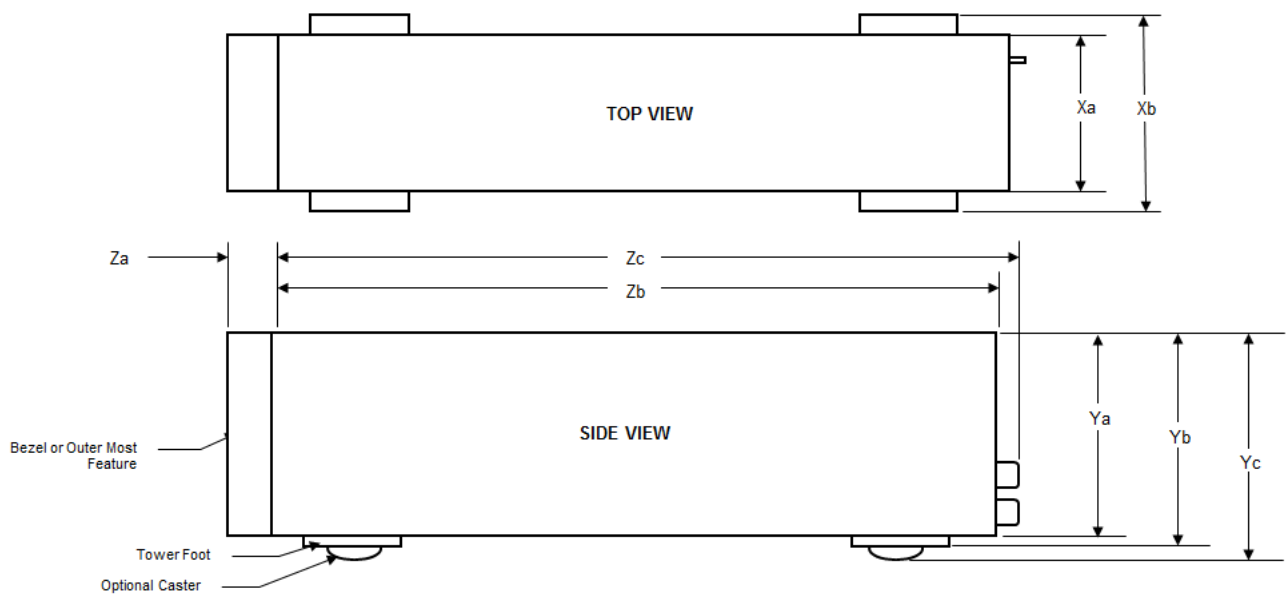


图 1: 机箱尺寸

表. 1: Dell EMC PowerEdge T340 机箱尺寸

Xa	Xb	Ya	Yb	Yc	Za	Zb	Zc
218 毫米 (8.58 英寸)	307.9 毫米 (12.12 英寸)	430.3 毫米 (16.94 英寸)	443.3 毫米 (17.45 英寸)	471.3 毫米 (18.56 英寸)	带挡板: 14.1 毫米 (0.56 英 寸)	545.4 毫米 (21.47 英寸)	589.1 毫米 (23.19 英寸)

系统重量

表. 2: Dell EMC PowerEdge T340 系统机箱重量

系统配置	最大重量 (包括所有驱动器/SSD)
8 x 3.5 英寸驱动器	26 千克 (57.32 磅)

处理器规格

表. 3: Dell EMC PowerEdge T340 处理器规格

支持的处理器	支持的处理器数量
英特尔至强处理器 E-2200 产品系列 英特尔酷睿 i3 9100 处理器 英特尔奔腾 G5420 处理器 英特尔赛扬 G4930 处理器 英特尔至强处理器 E-2100 产品系列 英特尔酷睿 i3 8100 处理器 英特尔奔腾 G5500 处理器 英特尔赛扬 G4900 处理器	一声

支持的操作系统

Dell EMC PowerEdge T340 支持以下操作系统:

- Canonical Ubuntu LTS
- Citrix Hypervisor
- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMWare ESXi

 注: 有关详情, 请转至 www.dell.com/ossupport。

PSU 规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持多达两个交流电源装置 (PSU)。

表. 4: Dell EMC PowerEdge T340 PSU 规格

PSU	分类	散热 (最大)	频率	电压	交流		直流	当前
					高压线路 (100–240 V)	低压线路 (100–120 V)		
495 W 交流	白金级	1908 BTU / 小时	50/60 Hz	100–240 V 交流, 自动调节范围	495 W	不适用	不适用	6.5 A–3 A
350 W AC	青铜级	1455 BTU/小时	50/60 Hz	100–240 V 交流, 自动调节范围	350 W	不适用	不适用	5.5 A–3 A

冷却风扇规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持一个系统冷却风扇。

注: 选择或升级系统配置时, 为了确保最佳电源利用率, 请使用 Dell.com/ESSA 上的戴尔能源智能解决方案顾问验证系统功耗。

系统电池规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持 ts CR 2032 3.0-V 锂币系统电池。

扩充卡规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持多达四个 PCI express (PCIe) 3.0。

表. 5: 系统板上支持的扩充卡插槽

PCIe 插槽	处理器连接	PCIe 插槽高度	PCIe 插槽长度	插槽宽度
插槽 1 (Gen3)	处理器	全高	半长	x8 插槽中的 x8 链路
插槽 2 (Gen3)	处理器	全高	半长	x16 插槽中的 x8 链路
插槽 3 (Gen3)	平台控制器集线器	全高	半长	x1
插槽 4 (Gen3)	平台控制器集线器	全高	半长	x8 插槽中的 x4 链路

注: 该扩展卡不能热插拔。

内存规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持以下内存规格以优化操作:

表. 6: 内存规格

DIMM 类型	DIMM 列	DIMM 容量	最小 RAM	最大 RAM
UDIMM	单列	8 GB	8 GB	32 GB
		16 GB	16 GB	64 GB
	双列	8 GB	8 GB	32 GB
		16 GB	16 GB	64 GB

表. 6: 内存规格

内存模块插槽	速度
四个 288 针	2666 MT/s 2400 MT/s 2133 MT/s

i 注: 从 BIOS 版本 2.5.1 开始兼容 3200 MT/s UDIMM, 但运行速度降为 2666 MT/s。

存储控制器规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持以下控制器卡:

表. 7: Dell EMC PowerEdge T340 系统 控制器卡

内部控制器	外部控制器
<ul style="list-style-type: none">PERC H730PPERC H330S140HBA330	<ul style="list-style-type: none">12 Gb/s 外部 SAS HBAHBA355e

驱动器规格

驱动器

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持:

- 4 x 3.5 英寸 SAS、SATA 驱动器、2.5 英寸热插拔驱动器
- 8 x 3.5 英寸 SAS、SATA 驱动器、2.5 英寸热插拔驱动器

i 注: 3.5 英寸托架中的 2.5 英寸驱动器支持 SAS 和 SATA SSD 驱动器。

光盘驱动器

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持以下光盘驱动器。

表. 8: 支持的光驱类型

支持的驱动器类型	支持的驱动器数量
一个专用的 SATA DVD-ROM 驱动器或 DVD+/-RW 驱动器	一声

磁带驱动器

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持多达两个专用的 5.25 英寸磁带机。

端口和连接器规格

USB 端口规格

表. 9: Dell EMC PowerEdge T340 系统 USB 端口规格

前面板	背面板	内置 USB
<ul style="list-style-type: none">• 一个 USB 3.0 兼容端口• 一个 iDRAC USB 管理端口 (USB 2.0) <p>注: Micro USB 2.0 兼容端口只可以用作 iDRAC Direct 或管理端口。</p>	<ul style="list-style-type: none">• 两个 USB 3.0 兼容端口• 四个 USB 2.0 兼容端口	<ul style="list-style-type: none">• 一个内置 USB 3.0 兼容端口

NIC 端口规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统的底板上支持多达两个 10/100/1000 Mbps 网络接口控制器 (NIC) 端口。

串行连接器规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持背面板上的一个串行连接器，该 9 针连接器是一种兼容 16550 的数据终端设备 (DTE)。

VGA 端口规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统在系统背面支持一个 15 针 VGA 端口。

IDSDM 模块

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持可选的内部双 SD 模块 (IDSDM) 模块。

模块支持三个 MicroSD 卡 (两个卡适用于 IDSDM，一个卡适用于 vFlash)。在第 14 代 PowerEdge 服务器中，IDSDM 或 vFlash 模块组合为一个卡模块，并且在以下配置中提供：

- vFlash 或
- vFlash 和 IDSDM

表. 10: 支持的 microSD 卡存储容量

IDSDM 卡	vFlash 卡
<ul style="list-style-type: none">• 16 GB• 32 GB• 64 GB	<ul style="list-style-type: none">• 16 GB

注: IDSDM 或 vFlash 模块上有两个 DIP 开关以实现写保护。

注: 系统还提供一个专用的冗余 IDSDM 卡插槽。

注: 使用与 IDSDM 或 vFlash 配置的系统关联的 Dell EMC 品牌 microSD 卡。

视频规格

Dell EMC PowerEdge T340 系统支持 Matrox G200eR2 显卡和 16 MB 容量。

表. 11: 支持的视频分辨率选项

解决方案	刷新率	颜色深度 (位)
640x480	60、70	8、16、24
800x600	60、75、85	8、16、24
1024x768	60、75、85	8、16、24
1152x864	60、75、85	8、16、24
1280x1024	60、75	8、16、24

环境规格

注: 有关环境认证的其他信息, 请参阅手册和说明文件中的“产品环境数据表”, 网址: www.dell.com/support/home。

表. 12: 温度规格

温度	规格
存储	-40 至 65 °C (-40 至 149 °F)
连续工作 (在低于海拔 950 米或 3117 英尺时)	在设备无直接光照的情况下, 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
新鲜空气	有关新风的信息, 请参阅扩展操作温度部分。
最高温度梯度 (操作和存储)	20°C/h (68°F/h)

表. 13: 相对湿度规格

相对湿度	规格
存储	最大露点为 33°C (91°F) 时, 相对湿度为 5% 至 95%。 空气必须始终不冷凝。
使用时	最大露点为 29°C (84.2°F) 时, 相对湿度为 10% 至 80%。

表. 14: 最大振动规格

最大振动	规格
使用时	5 Hz 至 350 Hz 时, 0.26 G _{rms} (所有操作方向)
存储	10 Hz 至 500 Hz 时, 1.88 G _{rms} , 可持续 15 分钟 (被测的所有六面)

表. 15: 最大撞击脉冲规格

最大撞击脉冲	规格
使用时	在 x、y 和 z 轴正负方向上可承受 6 G 连续执行的撞击脉冲, 最长可持续 11 毫秒。
存储	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 最长可持续 2 毫秒。

表. 16: 最大海拔高度规格

最大海拔高度	规格
使用时	3048 米 (10,000 英尺)
存储	12,000 米 (39,370 英尺)

表. 17: 工作温度降额规格

工作温度降额	规格
高达 35 °C (95 °F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1 °C/300 米 (1 °F/547 英尺) 降低。
35-40 °C (95-104 °F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1 °C/175 米 (1 °F/319 英尺) 降低。
40-45 °C (104-113 °F)	最高温度在 950 米 (3,117 英尺) 以上时按 1 °C/125 米 (1 °F/228 英尺) 降低。

标准操作温度

表. 18: 标准操作温度规格

标准操作温度	规格
连续工作 (在低于海拔 950 米或 3117 英尺时)	在设备无直接光照的情况下, 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)。

扩展操作温度

表. 19: 扩展操作温度规格

扩展操作温度	规格
连续工作	<p>5 °C-40 °C, 相对湿度为 5 %-85 %, 露点为 29 °C。</p> <p>注: 在标准操作温度范围 10 °C-35 °C 之外, 系统可以在低至 5 °C、高至 40 °C 的温度下连续工作。</p> <p>若温度在 35 °C 至 40 °C 之间, 在 950 米 (3,117 英尺) 以上时, 每上升 175 米, 最大允许温度将下降 1°C (每 319 英尺下降 1°F)。</p>
≤ 每年操作时间的 1%	<p>-5 °C 至 45 °C, 相对湿度为 5 % 至 90 %, 露点为 29 °C。</p> <p>注: 除了标准操作温度范围 (10 °C-35 °C) 之外, 系统能在最低 -5 °C 或最高 45 °C 的温度下运行, 运行时间长达每年操作时间的 1%。</p> <p>若温度在 40 °C 和 45 °C 之间, 在 950 米 (3,117 英尺) 以上时, 每上升 125 米, 最大允许温度将下降 1°C。</p>

注: 在扩展温度范围下操作时, 系统性能将会受到影响。

注: 在扩展温度范围下操作时, 系统事件日志中可能会有环境温度警告。

扩展操作温度限制

- 请勿在 5 °C 以下冷启动系统。
- 指定的操作温度适用于在最高海拔高度 950 米进行新风冷却。
- 需要两个冗余电源装置。
- 由于系统中仅包含单个风扇, 因此不支持冷却冗余。
- 支持最高 80 W 的处理器。
- 需要一个系统风扇。
- 不支持非 Dell 认证的外围设备卡和/或超过 25 W 的外围设备卡。
- 不支持 GPU。
- 支持磁带备份单元。

微粒和气体污染规格

下表定义了限制范围，帮助避免任何 IT 设备损坏和/或微粒和气体污染故障。如果颗粒或气体污染级别超过指定的限制范围并导致设备损坏或发生故障，您可能需要改善环境条件。整改环境条件是客户的责任。

表. 20: 微粒污染规格

微粒污染	规格
空气过滤	按照 ISO 14644-1 第 8 类定义的拥有 95% 置信上限的数据中心空气过滤。 注: 此情况仅适用于数据中心环境。空气过滤要求不适用于旨在数据中心之外（诸如办公室或工厂车间等环境）使用的 IT 设备。 注: 进入数据中心的空气必须拥有 MERV11 或 MERV13 过滤。
导电灰尘	空气中不得含有导电灰尘、锌晶须或其他导电颗粒。 注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。
腐蚀性灰尘	<ul style="list-style-type: none">空气中不得含有腐蚀性灰尘。空气中的残留灰尘的潮解点必须小于 60% 相对湿度。 注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。

表. 21: 气体污染规格

气体污染	规格
铜片腐蚀	<300 Å/月，按照 ANSI/ISA71.04-1985 定义的 G1 类标准。
银片腐蚀	<200 Å/月，按照 AHSRAE TC9.9 定义的标准。

注: 腐蚀性污染物最大浓度值在小于等于 50% 相对湿度下测量。